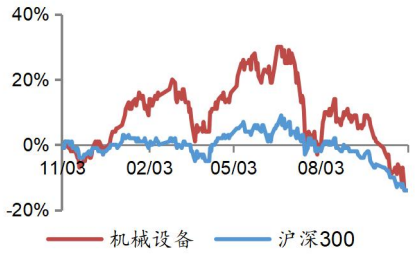
金刚石散热产业化初步突破，PCB 设备业绩高增

行业评级： 增持

报告日期： 2026-11-02

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：王璐
执业证书号：S0010525040001
邮箱：wanglu1@hazq.com

分析师：陶俞佳
执业证书号：S0010524100004
邮箱：taoyujia@hazq.com

分析师：邓天舒
执业证书号：S0010526090001
邮箱：dengtianshu@hazq.com

相关报告

1.关注硅光晶圆激光隐切环节、物理 AI 2026-10-26
2.关注 PCB 喷印设备、MPO 插芯设备 2026-10-21
3.关注 PCB 设备、MPO 插芯设备、液冷检测设备 2026-10-12

主要观点：

● **板块表现**

机械设备（申万）板块，本周（2026.10.26-2026.10.30）-8.2%，近 30 日-15.8%，YTD-17.8%。从机械设备申万二级分类来看，本周通用设备-9.9%、专用设备-8.1%、轨交设备-1.7%、工程机械-4.1%、自动化设备-9.4%。

● **PCB 设备头部企业三季报综述：2026 年前三季度业绩高增**

1）财务：主要 PCB 设备头部企业业绩全面高增，利润增速显著高于营收增速。2026 年前三季度，大族数控营收 78.4 亿元（+101%），归母净利 15.4 亿元（+214%），毛利率 37%（+5pct），净利率 20%（+8pct），合同负债 5.0 亿元（同比+1044%）；鼎泰高科营收 34.9 亿元（+139%），归母净利 11.5 亿元（+307%），毛利率 53%（+13pct），净利率 33%（+14pct）；芯碁微装营收 17.8 亿元（+91%），归母净利 4.6 亿元（+132%），毛利率 44%（+1pct），净利率 26%（+5pct），合同负债 1.8 亿元（同比+167%）；东威科技营收 11.0 亿元（+46%），归母净利 1.6 亿元（+91%），毛利率 36%（+2pct），净利率 15%（+3pct），合同负债 13.7 亿元（同比+144%）。四家利润增速均大幅高于营收增速，毛利率、净利率全面上行，合同负债全线高增，验证 AI 扩产周期下“产品结构升级+规模效应”双击逻辑，行业盈利质量处于上行通道。

2）分工序来看：

A）钻孔环节（大族数控、鼎泰高科）：大族数控机械钻孔仍为收入主体，受 AI 算力板及高速光模块需求驱动，激光类钻孔设备、CCD 背钻机等高端产品占比持续提升，高难度加工场景带动设备单机价值量上行，根据大族数控 27-29 年的股权激励计划，考核触发线平滑下来相当于每年扣非净利润增长约 24%，考核目标线相当于每年增长约 30%；鼎泰高科钻针业务量价齐升，高长径比、微小径等高端产品占比稳步提升，价格传导顺畅，产能持续爬坡。

B）曝光环节（芯碁微装）：PCB 直写成像设备需求旺盛，mSAP 工艺渗透与载板扩产驱动订单持续高增，先进封装设备已由验证导入转向规模交付，半导体业务收入占比显著提升，海外客户拓展取得实质进展。

C）电镀环节（东威科技）：脉冲式/水平镀三合一等高端 PCB 电镀设备放量，毛利率同比明显提升，收入利润延续高增。

3）总结：2026 年为 AI 全行业投资元年，1.6T 高速光模块 mSAP 产能预计 2027 年集中落地，M9 等新一代板材应用带动钻孔/曝光电镀等工序技术迭代及存量设备刚性替换。

● **金刚石散热：沃尔德中标曙光数创金刚石单晶方案，产业化应用进一步推进**

根据 2026.10.30 披露的沃尔德投资者交流公告，沃尔德参与了曙光数创相关招投标，金刚石单晶方案中标，为客户供应商之一。沃尔德此次进入供应商名单，代表公司具备相应供应资格。此次招标是金刚石散热在

芯片端实现的商业化突破，标志着我国金刚石散热产业由小批量验证迈向批量化生产阶段，产业规模化应用进一步推进。

相关标的：沃尔德、四方达、国机精工。

- **风险提示**

PCB 扩产及技术升级不及预期的风险；液冷订单不及预期及技术变化带来的风险；MPO 插芯设备产业化不及预期的风险；芯片电感市场需求不及预期的风险；AIDC 电源方案变化及交付不及预期的风险；金刚石散热技术应用进展不及预期；工业母机下游需求不及预期及原材料风险，具身机器人产品放量不及预期。

正文目录

1 板块逻辑及相关标的 5
1.1 PCB 设备：AIPCB 扩产及新技术升级带动需求，具备高景气延续性 5
1.2 液冷及液冷设备：26H2 液冷订单拐点将至，相关设备需求逐步放量 5
1.3 光通信设备 6
1.3.1 MPO 插芯设备：芯数提升与人工良率下降，倒逼插芯自动化设备需求 6
1.3.2 硅光晶圆激光隐切：硅光渗透率提升为确定性趋势，硅光晶圆隐切环节受益 7
1.4 芯片电感：AI 芯片功率提升，芯片电感具备市场扩容逻辑 8
1.5 AI 发电设备：行业领先企业的燃气轮机订单可见度至 2029 年，SOFC 等其他供电方案需求提升 8
1.5.1 燃气轮机：高景气有望延续至 2027 年，订单确定性可看至 2029 年 9
1.5.2 SOFC 等其他电源：作为 AIDC 发电方式的补充，重视其需求提升逻辑且已有商业化落地 10
1.6 金刚石散热：重点关注积极进行下游产品验证及设备扩产的厂商 10
1.7 工业母机：重点关注人形机器人、AI 算力等景气下游的市场开拓 11
2 板块动态跟踪 12
2.1 PCB 设备 12
2.2 液冷及液冷设备 13
2.3 光通信设备 13
2.4 芯片电感 13
2.5 AI 发电设备 14
2.6 金刚石散热 15
2.7 工业母机 15
风险提示 16

图表目录

图表 1 PCB 设备板块行情跟踪 5
图表 2 液冷及液冷设备板块行情跟踪 6
图表 3 光通信设备板块行情跟踪 8
图表 4 芯片电感板块行情跟踪 8
图表 5 燃气轮机板块行情跟踪 9
图表 6 SOFC 等其他电源板块行情跟踪 10
图表 7 金刚石散热板块行情跟踪 11
图表 8 工业母机板块行情跟踪 11
图表 9 PCB 设备板块公司公告更新 12
图表 10 液冷及液冷设备板块公司公告更新 13
图表 11 光通信设备板块公司公告更新 13
图表 12 芯片电感板块公司公告更新 13
图表 13 燃气轮机板块公司公告更新 14
图表 14 SOFC 等其他电源板块公司公告更新 14
图表 15 金刚石散热板块公司公告更新 15
图表 16 工业母机板块公司公告更新 15

1 板块逻辑及相关标的

1.1 PCB 设备：AIPCB 扩产及新技术升级带动需求，具备高景气延续性

PCB 设备板块整体逻辑：1）总需求量提升：AIPCB 扩产带来设备需求提升。2）部分环节单机价值量提升：受益于 AIPCB 工艺提升，部分环节如曝光、电镀、层压、大尺寸回流焊等设备单机价值量较此前提升。3）新工艺带来新设备需求：PCB 材料体系升级，带来如激光钻孔设备、PCB 检测等新设备需求。

投资策略：1）在确定性高的细分环节（如产品已有重复订单）中优选行业卡位好、估值低标的；2）在确定性有待验证的细分环节（如产品在送样阶段，暂无重复订单）中需要紧跟公司订单动态；3）此外，部分公司在技术同源背景下，向泛半导体等其他环节的拓展，应给予关注。

相关标的：大族激光、芯碁微装、合锻智能、宏华数科、英诺激光、德龙激光、鼎泰高科、民爆光电等。

图表 1 PCB 设备板块行情跟踪

	相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1	大族激光	PCB设备	-18%	-38%	23%
2	大族数控	PCB钻孔设备	-18%	-41%	15%
3	合锻智能	PCB层压机	-9%	-30%	-28%
4	芯碁微装	PCB曝光机	-24%	-46%	59%
5	东威科技	PCB电镀设备	-21%	-42%	1%
6	三孚新科	PCB电镀设备	-24%	-43%	-9%
7	洪田股份	PCB电镀设备	-12%	-35%	-28%
8	宏华数科	PCB喷印设备	-9%	-15%	-46%
9	英诺激光	超快激光钻孔设备	-17%	-40%	-2%
10	德龙激光	超快激光钻孔设备	-9%	-32%	39%
11	鼎阳科技	PCB检测设备	-19%	-42%	62%
12	日联科技	PCB检测设备	-21%	-41%	16%
13	奕瑞科技	PCB检测设备	-7%	-14%	0%
14	康众科技	PCB检测设备部件	-4%	-9%	-24%
15	劲拓股份	PCBA大尺寸回流焊设备	-18%	-35%	11%
16	凯格精机	锡膏印刷设备	-18%	-35%	-7%
17	鼎泰高科	钻针	-23%	-46%	37%
18	民爆光电	钻针	-21%	-36%	129%
19	新锐股份	钻针	-19%	-48%	19%
20	欧科亿	钻针	-25%	-38%	58%
21	中钨高新	钻针	-15%	-33%	30%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.2 液冷及液冷设备：26H2 液冷订单拐点将至，相关设备需求逐步放量

液冷板块逻辑：受益于 AI 发展，AIDC 机柜芯片功耗提升，进而对芯片散热要求提高，机柜液冷市场空间从 0 到 10 的跨越式增长。从市场格局来看，台厂为主导，大陆厂大部分满足台厂代工需求、小部分可直接对接海外订单。从节奏来看，26H2 逐渐进入液冷订单小批量拐点，2027 年有望看到批量订单落地。

液冷设备板块逻辑：2026 年内，随着液冷厂订单落地，产能扩建开始，液冷 CNC 加工机床及检测设备需求提升。

投资策略：核心关注公司下游客户（是否直接或间接进入核心供应链体系）、液冷产品进展及确定性（送样或订单，小批量订单或正式批量订单，订单体量）、产能情况（是否具备满足订单需求的产能，或是否具备扩产能力及计划）。

相关标的：皖仪科技、爱克股份、华翔股份、同飞股份等。

图表 2 液冷及液冷设备板块行情跟踪

	相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1	英维克	液冷系统	-15%	-32%	-54%
2	高澜股份	液冷系统	-12%	-30%	-23%
3	申菱环境	液冷系统、CDU等	-19%	-35%	31%
4	同飞股份	CDU等	-22%	-21%	-13%
5	鸿富瀚	液冷系统	-2%	-21%	57%
6	思泉新材	液冷系统	-15%	-34%	-48%
7	爱克股份	液冷系统	-7%	-22%	-18%
8	冰轮环境	冷水机组	-16%	-36%	32%
9	磁谷科技	冷水机组、压缩机	-26%	-38%	13%
10	汉钟精机	压缩机	-11%	-22%	-21%
11	鑫磊股份	压缩机	-16%	-35%	-10%
12	中石科技	光模块散热	-8%	-36%	41%
13	鼎通科技	光模块液冷	-34%	-52%	-19%
14	奕东电子	光模块液冷	-22%	-41%	-44%
15	硕贝德	光模块液冷、液冷busbar	-14%	-17%	-50%
16	强瑞技术	manifold等	-20%	-38%	-7%
17	五洋自控	波纹管等	-4%	-19%	51%
18	金富科技	波纹管等	-11%	-26%	129%
19	大元泵业	液冷泵	-21%	-36%	1%
20	飞龙股份	液冷泵	-21%	-32%	7%
21	华翔股份	冷板等	-1%	-10%	-13%
22	创世纪	液冷机床设备	-9%	-10%	13%
23	乔锋智能	液冷机床设备	1%	-12%	36%
24	皖仪科技	液冷氦检设备	-6%	-23%	8%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.3 光通信设备

1.3.1 MPO 插芯设备：芯数提升与人工良率下降，倒逼插芯自动化设备需求

MPO 插芯设备核心逻辑：MPO（Multi-fiberPushOn）是光通信中实现多芯光纤高密度并行连接的核心连接器。其核心原理是通过 MT 插芯实现多根光纤精准对齐，以并行方式同时传输多路光信号，主要用于数据中心内部，在机柜内、机柜间或列间实现高速率、高密度、低损耗的光互联。MPO 连接器（跳线）的制造过程主要涵盖：注塑成型→真空灌胶→MT 插芯穿纤→光纤固定与研磨→检测等环节。由于 MPO 连接器的精密组装、研磨、检测等环节对设备精度要求极高（需在微米级别实现光纤对准），芯数从 8/12 芯向 16/24 芯乃至更高演进后，多根光纤的精密排列、固定与穿纤难度呈非线性上升，人工操作的良率与一致性大幅恶化，自动化插纤设备成为刚需。此外，NPO 与玻璃桥倒逼芯数升级，插芯自动化设备迎来发展窗口。

相关标的：瑞松科技。

1.3.2 硅光晶圆激光隐切：硅光渗透率提升为确定性趋势，硅光晶圆隐切环节受益

硅光晶圆激光隐切核心逻辑：硅光晶圆激光隐形切割用于硅光芯片后道晶圆分割环节，起到将整片硅光晶圆分离为独立光芯片的作用，是硅光芯片制造中连接晶圆制造与封装测试的关键工序，其加工质量直接影响芯片良率与光模块可靠性。区别于传统刀片切割，隐形切割基于超快激光在晶圆内部形成改性层（改质层）、再经扩片或裂片完成分离，切道窄、损伤低、良率优，适配硅光芯片薄片化、窄切割道、高边缘完整性的加工要求。硅光渗透率提升，硅光晶圆激光隐切环节受益：

1）光互联中的硅光渗透率提升为确定性趋势，硅光芯片市场空间预计从 2025 年的 13 亿美元提升至 2031 年的 63 亿美元（该口径不是仅指硅光 PIC 裸 die）。随着 AI 数据中心规模和算力互联需求的提升，数据中心客户在光互连部署中面临功耗高、空间受限、传输密度和可靠性要求提升的问题，因此相对低功耗、高功率、高密度、集成的光互连继续需求持续增长，推动了硅光、相干光通信、线性光学等技术的发展趋势。传统光模块可以采用激光器、调制器、探测器、透镜、隔离器和无源光学件等分离方案，但随着通道数增加，如果依靠分立器件堆叠会出现器件数增加、封装空间受限、成本上升等一系列问题。而硅光技术路径可以在同一个光芯片里集成波导、调制器、耦合器等结构，把原本依赖手工逐颗精密组装的光学系统，部分转化为利用半导体晶圆制造的集成电路，且可实现 CMOS 工艺兼容，系统级解决光互连不断提出的高功耗、空间受限、高密度挑战。此外，对于光学集成要求更高的 CPO 正在加速硅光技术路径的采用。根据中际旭创港股招股书，全球数通光互连市场空间（按收入口径）预计由 2026 年的 307 亿美元，提升至 2030 年的 986 亿美元，2026-2030 年 CAGR 34%，其中光模块占市场的绝大部分。根据 2026 年 5 月 LightCounting 数据，2025 年光芯片市场空间约 40 亿美元，预计至 2031 年达到 150 亿美元，2025-2031 年 CAGR25%；其中，2025 年硅光芯片占比 32%，市场空间约 13 亿美元，预计至 2031 年占比提升至 42%，市场空间达到 63 亿美元，2025-2031 年 CAGR30%（LightCounting 统计口径：用于光收发器、AOC、LPO、CPO/NPO 中的全部有源光芯片，这里的硅光芯片并不仅指硅光 PIC 裸 die）。根据 2026 年 4 月中际旭创投资者关系活动表，中际旭创 1.6T 和 800G 光模块中，硅光技术占比已超过一半以上。

2）激光隐切的基本原理为激光穿过晶圆表面或背面，聚焦到硅内部，沿切割道形成内部改质层，扩膜或施加应力，最终硅光晶圆分离成硅光 PIC 裸片。对于高价值、大尺寸硅光芯片、后续涉及高精度芯片键合、薄晶圆、机械损伤敏感、需要边缘耦合且现有机械切割工艺良率不足的情况适合使用激光隐切工艺。由于硅光芯片表面存在波导、光栅耦合器等，如果使用机械切割通常伴随颗粒和污染，影响芯片键合、光纤耦合和光学性能，隐切属于干式、低接触工艺，可以减少颗粒污染；此外，硅光芯片部分结构靠近切割道，机械刀片切割可能造成崩边、微裂纹，进而降低良率和长期可靠性，激光隐切没有刀片直接接触；最后，机械切割需要容纳刀片宽度及崩边余量，隐切改质区域较窄，有机会缩小切割道。

九州一轨的子公司晶禧半导体凭借 99.8%的良率水平、微米级切割精度和国内稀缺的硅光晶圆激光隐形切割量产能力，已建立技术与客户双重壁垒，公司在硅光晶圆切割方面提供“隐形切割+晶圆减薄+贴膜/扩片/UV 解胶+裂片+AOI 分选”一站式服务，单片加工价值量较高。

投资策略：核心关注客户拓展（是否切入头部光模块/硅光芯片厂商供应链）、加工能力（是否具备 8/12 英寸硅光晶圆隐形切割及“切割+减薄+分选”一体化量产能力）、产能（硅光隐切产能规划与投产节奏）、订单（是否获得硅光客户认证与订单）。

相关标的：九州一轨。

图表 3 光通信设备板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 瑞松科技	MPO插芯设备	-15%	-41%	35%
2 九州一轨	晶圆隐切加工	-5%	-27%	332%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.4 芯片电感：AI 芯片功率提升，芯片电感具备市场扩容逻辑

芯片电感核心逻辑：芯片电感用在芯片外围电路或模块内部，起到给芯片前置供电的作用，主要承担滤波与平滑电流、储能、抗阻匹配、抗干扰等角色，是电子电路中不可或缺的三大被动元器件（电阻、电容、电感）之一。随着 AI 芯片功率提升，芯片电感具备市场扩容逻辑：1）量增：芯片功率提升，在芯片低压大电流的要求下，单芯片对应的电相数提升，单芯片的电感用量与芯片功耗呈近似线性正相关。2）价升：从 B 系列向 Rubin 系列升级，芯片供电模式从平面供电，向垂直供电升级，芯片电感从单相电感向 TLVR 电感升级，单颗芯片电感价值量提升。根据铂科新材招股书，全球 AI 芯片电感市场空间有望从 2025 年的 58 亿增长至 2030 年 269 亿元，25-30 年 CAGR 达 36%。

投资策略：核心关注公司下游客户（是否切入海外核心供应链）、产品（是否具备 TLVR 制备能力）、产能（产能规划情况）、订单（是否具备明确的订单体量）情况。

相关标的：横店东磁、铂科新材、龙磁科技等。

图表 4 芯片电感板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 横店东磁	芯片电感	-8%	-18%	-15%
2 铂科新材	芯片电感	-8%	-20%	27%
3 龙磁科技	芯片电感	-22%	-35%	94%
4 麦捷科技	芯片电感	-14%	-26%	21%
5 顺络电子	芯片电感	-4%	-18%	16%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.5 AI 发电设备：行业领先企业的燃气轮机订单可见度至 2029 年，SOFC 等其他供电方案需求提升

AI 发电设备核心逻辑：美国 AI 数据中心建设规划快速提升，AIDC 用电需求打破了美国电力长期的中低速增长停滞，而美国电网是为渐进式负载增长而设计的，因此美国发电项目从开始申请到商业化运营并网的平均排队时间为 5 年，出现了美国 AIDC 用电规划激增和美国新增电源落地缓慢的矛盾。为解决这个问题，大型数据中心从单纯从电网购电，转向通过自建电源和从电网购电相结合来解决用电问题。**1）燃气轮机：**根据 rabobank 测算，美国数据中心项目计划容量超过 160GW，已有超过 130GW 宣布使用共址能源资源（负载和发电设施共址）提供电力，燃气发电占 80%以上。燃机的主导地位主要系其燃机具备高发电效率、燃气电站有相对较低的建设周期、且可实现稳定供电。燃气轮机历史需求增长平缓，全球产能主要集中在 GEV、三菱重工、西门子能源等巨头，其扩产节奏相对缓慢，AIDC 对燃机需求的快速增长，既带来了相关燃机公司未来 2-3 年订单和业绩的确定性，又导致了新增燃机订单交期持续拉长（根据 GEV 访谈，2026 年新签订燃机单预计 2029 年交付）。**2）SOFC 等其他电源方式：**因此，SOFC，往复式发动机、航改燃等小型机组，这些部署时间短于重型燃机的供电方式也逐渐体现需求的增长。

1.5.1 燃气轮机：高景气有望延续至 2027 年，订单确定性可看至 2029 年

燃气轮机：燃气轮机具备高转换效率、低建设周期优势，是 AIDC 稳定供电的优选电源方案。燃气轮机是发电效率较高的商业化发电装备，燃气轮机与蒸汽轮机组成的联合循环机组，发电效率可达 64%以上（来源：西门子能源官网，HL 级联合循环效率可达 64%），远超煤电发电水平（我国煤电发电效率普遍低于 50%）；中小型单循环燃气轮机（不含余热锅炉、蒸汽轮机）冷启动至满负荷 30 分钟以内，重型联合循环机组从冷启动至满负荷约 200 分钟，燃气电站从开工到投产的建设周期 1-2 年（不含前期核准征地）。

美国数据中心用电需求：

根据 BNEF（截至 2026 年 7 月 29 日），2024/2025 年美国数据中心装机电力容量为 35/55GW，预计 2026/2027/2028 为 66/77/88GW，并预计 2030 年增至 118GW，2035 年为 194GW。

燃气电站建设需求：

1）BNEF：根据 BNEF 统计，截至 2026 年 7 月 29 日，已宣布建设 124GW 燃气电站用于数据中心，但其中有明确投产日期的占 56%。

2）三菱重工：根据三菱重工 2026 年 2 月发布的 2025 财年前三季度财报问答纪要，预计 2025-2027 每年全球燃气轮机整体市场需求约 70GW，2025 年全球燃气轮机需求阶段性冲高至近 100GW，预计中长期市场需求回落至 50GW/年。2026 年 9 月 21 日，三菱重工美国公司董事长兼 CEOTakaoTsukui 在接受采访时表示，受美国人工智能数据中心建设需求推动，2026 年全球燃气轮机需求预计与 2025 年（100GW）持平或更高，全年有望再次超过 100GW，并预计这一强劲需求将延续至 2027 年。

燃气轮机供给侧：

GEV：根据 2026 年 3 月 GEV 交流访谈，2025Q1/Q2/Q3/Q4 燃气轮机新签订单 8/9/12/24GW，预计 2026Q1 新签 12-24GW，至 2025 年底在手订单 83GW。根据 2026 年 7 月公布的 2026Q2 财报，预计 2026 年底公司在手订单 125GW。公司目前已经将 2028 年的产能售罄，并预计在 2026 年底将 2030 年前的产能售罄。产能方面，根据 2026Q2 财报，公司计划在 2026H2 开始扩产，2026 年三季度燃气轮机年产 20GW，计划 2028 年提升至 24GW，2030 年提升至 30GW。

相关标的：杰瑞股份、隆达股份等。

图表 5 燃气轮机板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 杰瑞股份	燃气轮机发电机组	-4%	-19%	26%
2 长源东谷	燃气轮机发电机组	-17%	-32%	23%
3 中国动力	中小型燃机	-6%	-12%	46%
4 应流股份	燃机叶片	-5%	-13%	-23%
5 万泽股份	燃机叶片	-17%	-27%	-27%
6 航宇科技	燃机环锻件	-14%	-25%	-41%
7 豪迈科技	燃机缸体等部件铸造	3%	5%	-30%
8 联德股份	燃机部件	-12%	-24%	-21%
9 博盈特焊	中大型燃机必配设备（HRSG余热锅炉）	-17%	-23%	-42%
10 西子洁能	HRSG余热锅炉、SCR脱硝装置	-10%	-21%	-19%
11 隆达股份	燃机叶片高温合金	-15%	-41%	-4%
12 GE Vernova Inc	燃气轮机	5%	-11%	32%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.5.2 SOFC 等其他电源：作为 AIDC 发电方式的补充，重视其需求提升逻辑且已有商业化落地

燃料电池用于 AIDC 供电已有商业化落地，2026 年 4 月 Oracle 甲骨文确认其在新墨西哥州的 ProjectJupiterAI 数据中心园区将配置最高 2.45GW 的燃料电池全面为其供电。SOFC 具备的优势包括交付周期短、发电效率相对较高、可以模块化部署、可以直流输出减少交直流转换损耗、氮氧化物排放更少，其劣势包括单位成本相对较高、电堆寿命有限（BE 的 SOFC 电堆连续运行平均寿命约 5 年）。鉴于全球大功率工商业 SOFC 领先公司为 BloomEnergy（2024 年 AEP 和 BloomEnergy 签署约 1GW 燃料电池供应协议，为全球截至 2025 年最大规模的燃料电池采购订单），而 BE 的产能预计在 2026 年提升至 2GW，现有厂房产能上限为 5GW，因此，在现有全球大功率 SOFC 的产能规模限制下，其短期可被视为 AIDC 发电方式的补充。

相关标的：三环集团、春晖智控、振华股份等。

图表 6 SOFC 等其他电源板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 三环集团	电解质隔膜，BE供应商	-16%	-33%	74%
2 春晖智控	温度传感器，BE供应商	-20%	-31%	8%
3 振华股份	金属铬，BE供应商	-24%	-39%	-16%
4 壹连科技	电链接组件，BE定点	-8%	-23%	-36%
5 德昌电机控股	连接体，BE供应商	-3%	-25%	-54%
6 先导基电	子公司布局SOFC电解质片、金属连接体等	-19%	-41%	63%
7 壹石通	SOFC电堆及系统	-7%	-24%	-26%
8 潍柴动力	SOFC系统	-6%	-19%	22%
9 Bloom Energy	SOFC系统	5%	-30%	134%
10 FuelCell Energy	SOFC系统	1%	-34%	53%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.6 金刚石散热：重点关注积极进行下游产品验证及设备扩产的厂商

核心逻辑：GPU、ASIC 等高性能芯片功耗及热流密度持续提升，传统的铜、铝散热材料性能边界逐步显现，金刚石材料天然热导率分别达到铜、铝的 4 倍、8 倍以上，同时其膨胀系数与半导体芯片核心材料高度匹配，有望成为高热流密度芯片的重要增量散热材料。行业空间的扩容主要来自于两个方面：1）金刚石散热在芯片散热中渗透率提升：目前芯片散热仍以传统的铜铝散热方式为主，金刚石散热渗透率极低，随金刚石散热技术成熟及产量提升，金刚石散热在芯片散热中渗透率有望持续提升带动市场扩容；2）金刚石散热单机价值量提升：随 AI 算力产业发展，芯片功耗将进一步提升，提升对于高品质及大规格热沉片需求，带动金刚石散热单机价值量提升，带动市场扩容。根据 QY Research 数据，2025 年金刚石散热材料全球市场规模达 5.19 亿美元，根据我们测算预计 2032 年市场空间将达 97-974 亿元，空间广阔。

投资策略：产业进展核心主要在于以下几点：1）生产设备及工艺：金刚石合成工艺分为高温高压法和化学气相沉积法，MPCVD 法因没有电极污染被认为是较优方案，因此具备 MPCVD 设备研发及扩产能力成为行业内企业核心竞争优势；2）下游客户协同验证及拿单：行业竞争格局尚未成型，国内参与者多来自于传统超硬材料、装备制造、精密加工等多个领域，提前卡位及与头部客户协同研发及获取订单成为竞争重点。核心关注公司下游客户（是否切入海外核心供应链及验证进展）、设备（是否具备 MPCVD 设备自研自产能力）、产品（当前热沉片试样及量产尺寸）、产能（产能规划情况）、订单（是否具备明确的订单体量）情况。

相关标的：沃尔德、国机精工、四方达等。

图表 7 金刚石散热板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 国机精工	金刚石铜、MPCVD设备	-6%	-14%	21%
2 四方达	拟投建2.5万片金刚石项目	-14%	-38%	72%
3 沃尔德	扩产金刚石散热衬底	-7%	-30%	27%
4 黄河旋风	8英寸金刚石热沉片产线	-10%	-29%	86%
5 力量钻石	募投资金转向金刚石研发	0%	-21%	42%
6 九州一轨	投建金刚石芯片基板项目	-5%	-27%	332%
7 斯莱克	与北科联合开发热沉片样品	-13%	-30%	-33%

资料来源：choice，华安证券研究所

1.7 工业母机：重点关注人形机器人、AI 算力等景气下游的市场开拓

工业母机板块逻辑：工业母机即机床，是装备制造业基础设备，主要为下游提供技术装备服务。机床作为国之重器，从产品技术及市场层面具备持续提升空间：1）中高端产品国产替代：我国中高端机床特别是五轴市场长期被欧美及日本等高端机床厂商占据，自机床行业“十八罗汉”退场后以民营企业为主整机厂商持续提升产品及服务竞争力，我国机床厂商在中高端市占率持续提升；2）市场-内销中高端市场空间扩容：在人形机器人、航空航天、新能源汽车、AI 算力等新兴市场快速发展下，行业对高精度、自动化及复合化机床装备需求持续提升，带动机床市场高端化发展，中高端机床市场在需求引领下持续扩容；3）市场-外销市场进一步开拓：随我国“一带一路”战略带动国内企业出海，特别是新能源汽车出口高增，海外市场成为国产机床新的增量市场，有望持续带动国产机床公司市场扩容。

投资策略：核心关注公司产品重点布局中高端市场、积极切入高端景气下游（切入人形机器人、航空航天及 AI 算力等新兴市场）、前瞻及持续布局海外市场。

相关标的：海天精工、纽威数控、创世纪、浙海德曼。

图表 8 工业母机板块行情跟踪

相关公司	相关看点	周涨跌幅（%）（2026.10.26-2026.10.30）	近30天涨跌幅（%）	YTD（%）
1 秦川机床	机器人零部件机床	-5%	-1%	-27%
2 日发精机	机器人零部件机床	-2%	-2%	-2%
3 浙海德曼	机器人零部件机床	-5%	-8%	-48%
4 纽威数控	机器人零部件机床+出海	-7%	-19%	10%
5 创世纪	AI算力零部件机床	-9%	-10%	13%
6 乔锋智能	AI算力零部件机床	1%	-12%	36%
7 海天精工	AI算力零部件机床+出海	-2%	-6%	12%
8 科德数控	高端五轴机床	-9%	-23%	-31%
9 宇环数控	3C零部件机床	-5%	-19%	1%

资料来源：choice，华安证券研究所

2 板块动态跟踪

2.1 PCB 设备

图表 9 PCB 设备板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	洪田股份	洪田股份:关于2026年第三季度计提及转回资产减值准备的公告	其他
2	2026-10-31	洪田股份	洪田股份:2026年第三季度报告	三季度报告全文
3	2026-10-31	宏华数科	宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
4	2026-10-30	鼎阳科技	鼎阳科技:投资者关系活动记录表(2026年10月26日)	调研活动
5	2026-10-30	奕瑞科技	奕瑞科技:奕瑞科技2026年第三季度报告	三季度报告全文
6	2026-10-30	新锐股份	新锐股份:新锐股份2026年第三季度报告	三季度报告全文
7	2026-10-30	新锐股份	新锐股份:新锐股份关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告	增资扩股,募集资金使用情况报告
8	2026-10-30	新锐股份	新锐股份:新锐股份关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
9	2026-10-30	欧科亿	欧科亿:欧科亿2026年第三季度报告	三季度报告全文
10	2026-10-30	欧科亿	欧科亿:欧科亿关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
11	2026-10-30	德龙激光	德龙激光:德龙激光关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
12	2026-10-30	德龙激光	德龙激光:德龙激光2026年第三季度报告	三季度报告全文
13	2026-10-29	芯碁微装	芯碁微装:投资者关系活动记录表(2026-03)	调研活动
14	2026-10-29	凯格精机	凯格精机:2026年三季度报告	三季度报告全文
15	2026-10-29	三孚新科	三孚新科:关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	回购预案
16	2026-10-29	劲拓股份	劲拓股份:关于2025年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第一个归属期归属条件成就的公告	股权激励进展公告
17	2026-10-29	劲拓股份	劲拓股份:2026年三季度报告	三季度报告全文
18	2026-10-29	日联科技	日联科技:2026年第三季度报告	三季度报告全文
19	2026-10-29	康众科技	康众科技:康众科技关于计提资产减值准备的公告	其他
20	2026-10-29	康众科技	康众科技:康众科技2026年第三季度报告	三季度报告全文
21	2026-10-29	三孚新科	三孚新科:2026年第三季度报告	三季度报告全文
22	2026-10-29	合锻智能	合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
23	2026-10-29	凯格精机	凯格精机:关于回购公司股份方案的公告	回购预案
24	2026-10-29	大族激光	大族激光:关于控股股东部分股份质押的公告	股份质押、冻结
25	2026-10-29	芯碁微装	芯碁微装:2026年第三季度报告	三季度报告全文
26	2026-10-28	日联科技	日联科技:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告	回购实施公告
27	2026-10-28	鼎泰高科	鼎泰高科:关于回购公司股份方案的公告	回购预案
28	2026-10-28	鼎泰高科	鼎泰高科:关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
29	2026-10-28	鼎泰高科	鼎泰高科:2026年三季度报告	三季度报告全文
30	2026-10-27	英诺激光	英诺激光:2026年三季度报告	三季度报告全文
31	2026-10-27	英诺激光	英诺激光:关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告	其他
32	2026-10-27	鼎阳科技	鼎阳科技:鼎阳科技2026年三季度报告	三季度报告全文
33	2026-10-27	鼎阳科技	鼎阳科技:鼎阳科技2026年第三季度业绩说明会公告	其他
34	2026-10-27	民爆光电	民爆光电:2026年三季度报告	三季度报告全文
35	2026-10-26	中钨高新	中钨高新2026年10月24日投资者关系活动记录表	调研活动
36	2026-10-26	英诺激光	英诺激光:关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告	权益变动报告书
37	2026-10-26	日联科技	日联科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书	回购报告书

资料来源：choice，华安证券研究所

2.2 液冷及液冷设备

图表 10 液冷及液冷设备板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	申菱环境;申菱转债	申菱环境:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书	上市公告,其他
2	2026-10-31	申菱环境	申菱环境:2026年三季度报告	三季度报告全文
3	2026-10-31	高澜股份	高澜股份:关于以自有专利权进行质押贷款的进展公告	借贷
4	2026-10-30	飞龙股份	002536飞龙股份投资者关系管理信息20261030	调研活动
5	2026-10-30	鸿富瀚	鸿富瀚:301086鸿富瀚投资者关系管理信息20261030	调研活动
6	2026-10-30	大元泵业	大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2026年投资者关系活动记录表(2026-006)	调研活动
7	2026-10-30	冰轮环境	冰轮环境:000811冰轮环境投资者关系管理信息20261030	调研活动
8	2026-10-30	中石科技	中石科技:2026年三季度报告	三季度报告全文
9	2026-10-30	中石科技	中石科技:未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划	其他
10	2026-10-30	高澜股份	高澜股份:关于出售参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告	收购出售资产/股权
11	2026-10-30	思泉新材	思泉新材:关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
12	2026-10-30	思泉新材	思泉新材:2026年三季度报告	三季度报告全文
13	2026-10-30	同飞股份	同飞股份:2026年三季度报告	三季度报告全文
14	2026-10-30	大元泵业	大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
15	2026-10-30	汉钟精机	汉钟精机:2026年三季度报告	三季度报告全文
16	2026-10-29	冰轮环境	冰轮环境:000811冰轮环境投资者关系管理信息20261029	调研活动
17	2026-10-29	爱克股份	爱克股份:关于公司控股股东部分股份质押的公告	股份质押、冻结
18	2026-10-29	飞龙股份	飞龙股份:关于以自有专利权进行质押贷款的公告	借贷
19	2026-10-29	飞龙股份	飞龙股份:关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告	关联交易,增资扩股
20	2026-10-29	飞龙股份	飞龙股份:关于对外投资设立境外全资子公司的公告	投资设立公司
21	2026-10-29	飞龙股份	飞龙股份:2026年三季度报告	三季度报告全文
22	2026-10-29	强瑞技术	强瑞技术:关于2026年前三季度计提资产减值损失和信用损失的公告	其他
23	2026-10-29	爱克股份	爱克股份:关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
24	2026-10-29	强瑞技术	强瑞技术:2026年三季度报告	三季度报告全文
25	2026-10-29	爱克股份	爱克股份:2026年三季度报告	三季度报告全文
26	2026-10-29	磁谷科技	磁谷科技:南京磁谷科技股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
27	2026-10-29	磁谷科技	磁谷科技:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告	获得补贴(资助)
28	2026-10-29	金富科技	金富科技:2026年三季度报告	三季度报告全文
29	2026-10-29	鸿富瀚	鸿富瀚:2026年三季度报告	三季度报告全文
30	2026-10-29	鸿富瀚	鸿富瀚:关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
31	2026-10-29	冰轮环境	冰轮环境:2026年三季度报告	三季度报告全文
32	2026-10-28	鼎通科技;鼎通转债	鼎通科技:关于不向下修正“鼎通转债”转股价格的公告	转股价格调整和修正公告,其他,转股价格调整和修正
33	2026-10-28	鼎通科技;鼎通转债	鼎通科技:2026年第三季度报告	三季度报告,三季度报告全文
34	2026-10-28	乔锋智能	乔锋智能:2026年三季度报告	三季度报告全文
35	2026-10-28	乔锋智能	乔锋智能:关于注销德国子公司的公告	公司关联方基本资料变更
36	2026-10-27	硕贝德	硕贝德:关于控股股东部分股份解除质押的公告	股份质押、冻结
37	2026-10-27	高澜股份	高澜股份:2026年10月27日2026年第三季度网上业绩说明会投资者关系活动记录表	调研活动
38	2026-10-27	创世纪	创世纪:300083创世纪投资者关系管理信息20261027	调研活动
39	2026-10-27	硕贝德	硕贝德:2026年三季度报告	三季度报告全文
40	2026-10-27	奕东电子	奕东电子:2026年三季度报告	三季度报告全文
41	2026-10-27	创世纪	创世纪:2026年三季度报告	三季度报告全文
42	2026-10-27	英维克	英维克:2026年三季度报告	三季度报告全文
43	2026-10-26	英维克	英维克:2026年10月26日投资者关系活动记录表	调研活动
44	2026-10-26	申菱环境;申菱转债	申菱环境:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告	可转债发行结果,其他

资料来源：choice，华安证券研究所

2.3 光通信设备

图表 11 光通信设备板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2026年前三季度计提减值准备的公告	其他
2	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
3	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于签订服务合同暨关联交易的公告	关联交易,重大合同
4	2026-10-30	瑞松科技	瑞松科技:2026年第三季度报告	三季度报告全文
5	2026-10-28	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司投资者关系活动记录表	调研活动

资料来源：choice，华安证券研究所

2.4 芯片电感

图表 12 芯片电感板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-30	龙磁科技	300835龙磁科技投资者关系管理信息20261030	调研活动
2	2026-10-30	顺络电子	顺络电子:2026年10月29日投资者关系活动记录表	调研活动
3	2026-10-30	顺络电子	顺络电子:2026年三季度报告	三季度报告全文
4	2026-10-30	顺络电子	顺络电子:关于受让控股孙公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告	关联交易,股权转让,增资扩股
5	2026-10-30	顺络电子	顺络电子:关于全资子公司珠海顺络拟签署项目投资协议的公告	签订协议
6	2026-10-29	麦捷科技	麦捷科技:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告	回购进展情况
7	2026-10-29	顺络电子	顺络电子:关于为控股公司提供担保的进展情况公告	提供/对外担保公告
8	2026-10-28	铂科新材	铂科新材:2026年三季度报告	三季度报告全文
9	2026-10-27	龙磁科技	龙磁科技:关于实际控制人股份质押的公告	股份质押、冻结
10	2026-10-27	龙磁科技	龙磁科技:2026年三季度报告	三季度报告全文

资料来源：choice，华安证券研究所

2.5 AI 发电设备

图表 13 燃气轮机板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	中国动力	中国动力:中国动力2026年第三季度报告	三季度报告全文
2	2026-10-31	长源东谷	长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
3	2026-10-31	长源东谷	长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告	关联交易
4	2026-10-30	博盈特焊	博盈特焊:广东博盈特焊技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	增发预案
5	2026-10-30	航宇科技;航宇转债	航宇科技:航宇科技2026年第三季度报告	三季度报告,三季度报告全文
6	2026-10-30	航宇科技;航宇转债	航宇科技:航宇科技关于拟申请统一注册发行债务融资工具的公告	其它,其他
7	2026-10-30	应流股份	应流股份:应流股份2026年第三季度报告	三季度报告全文
8	2026-10-29	豪迈科技	豪迈科技:关于开展外汇套期保值业务的公告	其他
9	2026-10-29	豪迈科技	豪迈科技:关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告	关联交易
10	2026-10-29	豪迈科技	豪迈科技:2026年三季度报告	三季度报告全文
11	2026-10-29	西子洁能	西子洁能:关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告	其他
12	2026-10-29	西子洁能	西子洁能:2026年三季度报告	三季度报告全文
13	2026-10-28	杰瑞股份	杰瑞股份:2026年10月28日投资者关系活动记录表	调研活动
14	2026-10-27	万泽股份	万泽股份:2026年三季度报告	三季度报告全文
15	2026-10-27	隆达股份	隆达股份:关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告	其他
16	2026-10-27	隆达股份	隆达股份:关于公司为下属全资子公司提供担保的进展公告	提供/对外担保公告
17	2026-10-27	隆达股份	隆达股份:2026年第三季度报告	三季度报告全文
18	2026-10-27	长源东谷	长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告	回购进展情况,股本变动,回购实施公告
19	2026-10-27	联德股份	联德股份:联德股份2026年第三季度报告	三季度报告全文
20	2026-10-26	杰瑞股份	杰瑞股份:2026年10月22日-10月23日投资者关系活动记录表	调研活动
21	2026-10-26	博盈特焊	博盈特焊:2026年三季度报告	三季度报告全文

资料来源：choice，华安证券研究所

图表 14 SOFC 等其他电源板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	先导基电	先导基电:上海先导基电科技股份有限公司关于董事、高级管理人员增持股份计划时间过半暨增持进展公告	高管人员持股变动,股东/实际控制人股份增持
2	2026-10-30	FuelCell Energy Inc Pfd;燃料电池能源	Form txt 燃料电池能源: Statement of Beneficial Ownership by Certain Investors	SCHEDULE 13G/A
3	2026-10-30	Bloom Energy Corp-A	Form txt Bloom Energy Corp-A: Statement of Beneficial Ownership by Certain Investors	SCHEDULE 13G/A
4	2026-10-30	潍柴动力;潍柴动力	潍柴动力:2026年三季度报告	三季度报告全文
5	2026-10-30	先导基电	先导基电:上海先导基电科技股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
6	2026-10-30	先导基电	先导基电:上海先导基电科技股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告	关联交易,公司关联方基本资料变更
7	2026-10-30	先导基电	先导基电:上海先导基电科技股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告	关联交易,收购出售资产/股权
8	2026-10-30	壹石通	壹石通:壹石通2026年第三季度报告	三季度报告全文
9	2026-10-30	壹石通	壹石通:壹石通关于子公司拟对外出租部分房产的公告	其他
10	2026-10-30	壹石通	壹石通:壹石通关于2026年第三季度计提减值准备的公告	其他
11	2026-10-29	三环集团;三环集团	三环集团:2026年三季度报告	三季度报告全文
12	2026-10-29	振华股份;振26转债	振华股份:振华股份2026年三季度主要经营数据公告	月度经营情况,其它
13	2026-10-29	振华股份	振华股份:振华股份2026年第三季度报告	三季度报告全文
14	2026-10-28	先导基电	先导基电:上海先导基电科技股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告	借贷,股份质押、冻结
15	2026-10-27	春晖智控	春晖智控:2026年三季度报告	三季度报告全文
16	2026-10-26	壹连科技	壹连科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	其他

资料来源：choice，华安证券研究所

2.6 金刚石散热

图表 15 金刚石散热板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	黄河旋风	黄河旋风:华创证券关于杨锐所持河南黄河旋风限售股份解除限售的核查意见	保荐/核查意见
2	2026-10-31	黄河旋风	黄河旋风:关于部分限售股上市流通的公告	限售股份上市流通
3	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨关于公司2026年前三季度计提减值准备的公告	其他
4	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
5	2026-10-31	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于签订服务合同暨关联交易的公告	关联交易,重大合同
6	2026-10-31	四方达	四方达:关于公司及控股子公司为子公司提供担保的进展公告	提供/对外担保公告
7	2026-10-31	黄河旋风	黄河旋风:2026年三季度报告	三季度报告全文
8	2026-10-31	黄河旋风	黄河旋风:关于公司向银行融资提供资产抵押的公告	抵押
9	2026-10-30	沃尔德	沃尔德:投资者关系活动记录表(10月30日三季报业绩说明会)	调研活动
10	2026-10-30	斯莱克	斯莱克:关于公司第六期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告	员工持股计划
11	2026-10-30	力量钻石	力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告	其他
12	2026-10-30	力量钻石	力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告	吸收合并
13	2026-10-30	力量钻石	力量钻石:2026年三季度报告	三季度报告全文
14	2026-10-30	斯莱克	斯莱克:《内部控制制度》(2026年10月)	内部控制报告
15	2026-10-30	斯莱克	斯莱克:《募集资金管理制度》(2026年10月)	管理办法/制度
16	2026-10-30	斯莱克	斯莱克:2026年三季度报告	三季度报告全文
17	2026-10-30	国机精工	国机精工:国机精工集团股份有限公司未来三年(2026-2028)股东回报规划	其他
18	2026-10-30	国机精工	国机精工:关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告	关联交易,委托（受托）事项
19	2026-10-30	国机精工	国机精工:2026年三季度报告	三季度报告全文
20	2026-10-30	国机精工	国机精工:关于2026年前三季度利润分配预案的公告	分配预案
21	2026-10-30	沃尔德	沃尔德:2026年第三季度报告	三季度报告全文
22	2026-10-29	惠丰钻石	惠丰钻石:2026年三季度报告	三季度报告全文
23	2026-10-28	九州一轨	九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司投资者关系活动记录表	调研活动
24	2026-10-28	四方达	四方达:关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告	其他
25	2026-10-28	四方达	四方达:公司章程(2026年10月)	公司章程
26	2026-10-28	四方达	四方达:2026年三季度报告	三季度报告全文

资料来源：choice，华安证券研究所

2.7 工业母机

图表 16 工业母机板块公司公告更新

序号	公告日期	证券名称	标题	公告主题
1	2026-10-31	海天精工	海天精工:宁波海天精工股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
2	2026-10-30	秦川机床	秦川机床:关于2026年前三季度计提减值准备的公告	其他
3	2026-10-30	秦川机床	秦川机床:关于2026年前三季度利润分配预案的公告	分配预案
4	2026-10-30	秦川机床	秦川机床:2026年三季度报告	三季度报告全文
5	2026-10-30	秦川机床	秦川机床:关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的公告	收购出售资产/股权
6	2026-10-30	华中数控	华中数控:2026年三季度报告	三季度报告全文
7	2026-10-30	华中数控	华中数控:关于获得项目经费的公告	其他
8	2026-10-30	华中数控	华中数控:关于2026年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告	其他
9	2026-10-30	日发精机	日发精机:2026年三季度报告	三季度报告全文
10	2026-10-29	宇环数控	宇环数控:2026年三季度报告	三季度报告全文
11	2026-10-29	宇环数控	宇环数控:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	投资理财
12	2026-10-29	日发精机	日发精机:关于全资子公司完成工商变更登记的公告	公司关联方基本资料变更
13	2026-10-28	科德数控	科德数控:2026年10月投资者关系活动记录表	调研活动
14	2026-10-28	科德数控	科德数控:科德数控股份有限公司2026年第三季度报告	三季度报告全文
15	2026-10-28	乔锋智能	乔锋智能:2026年三季度报告	三季度报告全文
16	2026-10-28	乔锋智能	乔锋智能:关于注销德国子公司的公告	公司关联方基本资料变更
17	2026-10-28	浙海德曼	浙海德曼:浙海德曼2026年第三季度报告	三季度报告全文
18	2026-10-27	创世纪	创世纪:300083创世纪投资者关系管理信息20261027	调研活动
19	2026-10-27	创世纪	创世纪:2026年三季度报告	三季度报告全文
20	2026-10-27	创世纪	创世纪:公司章程(2026年10月)	公司章程
21	2026-10-27	创世纪	创世纪:关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告	关联交易
22	2026-10-27	创世纪	创世纪:防范控股股东及关联方占用资金管理制度(2026年10月)	管理办法/制度
23	2026-10-27	创世纪	创世纪:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	公司注册资本变更
24	2026-10-27	创世纪	创世纪:关于2026年第三季度计提减值及核销资产的公告	其他
25	2026-10-26	乔锋智能	乔锋智能:2026年第二次临时股东会决议公告	股东大会决议公告

资料来源：choice，华安证券研究所

风险提示

1、PCB 扩产及技术升级不及预期的风险：若 AIPCB 厂商扩产或资本支出不及预期，将影响 PCB 设备需求；PCB 新技术升级存在工艺及良率难点，若技术升级落地不及预期则影响相关 PCB 设备需求。

2、液冷订单不及预期及技术变化带来的风险：目前大部分液冷厂的订单体量处于小批量阶段，后续若批量订单落地时间不及预期，且后续散热方案变化，将影响相关厂商订单兑现。

3、MPO 插芯设备产业化不及预期的风险：MPO 插芯精度要求高、工艺难，若 MPO 插芯设备的产业化推广若不及预期，将影响相关公司订单兑现。

4、芯片电感市场需求不及预期的风险：英伟达后续系列机柜的三次侧供电方案暂未确定，芯片电感市场需求有不及预期的风险。

5、AIDC 电源方案变化及交付不及预期的风险：AIDC 供电有多种方案，目前主流为燃气轮机供电，后续若有新方案产生，或影响燃气轮机产业链企业订单兑现；当下燃气轮机交期拉长，若供应链产能紧张，或影响相关公司产品交付。

6、金刚石散热技术应用进展不及预期。芯片散热有多种方案，金刚石从材料性能来看具备较强优势，但技术仍在开发及验证时期，后续若有新方案或者技术验证不及预期，或影响金刚石散热企业持续拿单及扩产。

7、工业母机下游需求不及预期及原材料风险。机床行业需求与下游需求关联度较高，如果下游需求减弱则会影响工业母机企业订单及收入。同时，工业母机部分核心材料仍需进口，如果原材料价格提升则会影响相关公司利润。

分析师与研究助理简介

分析师：王璐，华安证券研究所机械设备组负责人。中国社会科学院大学本科，新加坡南洋理工大学硕士，曾任职于华创证券、华泰证券，5 年新能源及机械行业研究经验。
分析师：陶俞佳，华安证券研究所机械设备组分析师
分析师：邓天舒，华安证券研究所机械设备组分析师。复旦大学硕士，曾任职于方正证券。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。
本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。